

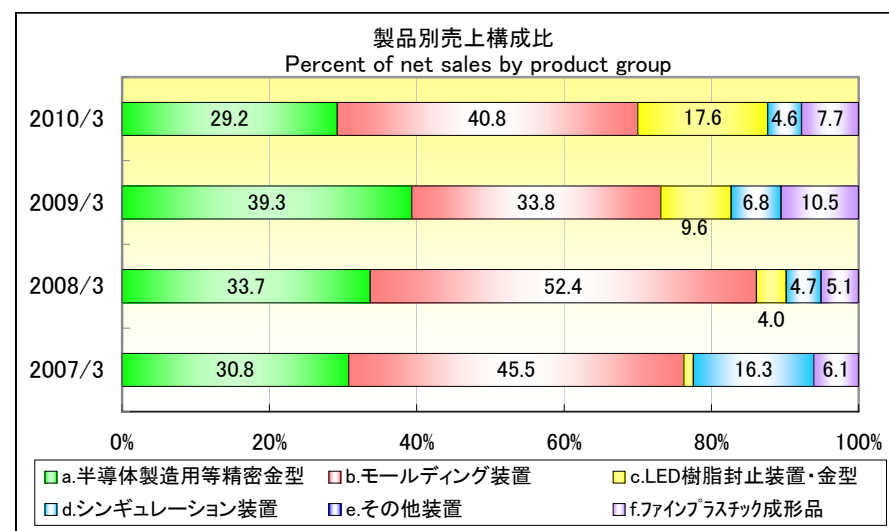
2010年3月期 決算補足資料 (2010年5月)



TOWA株式会社

東証1部・大証1部:6315

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)

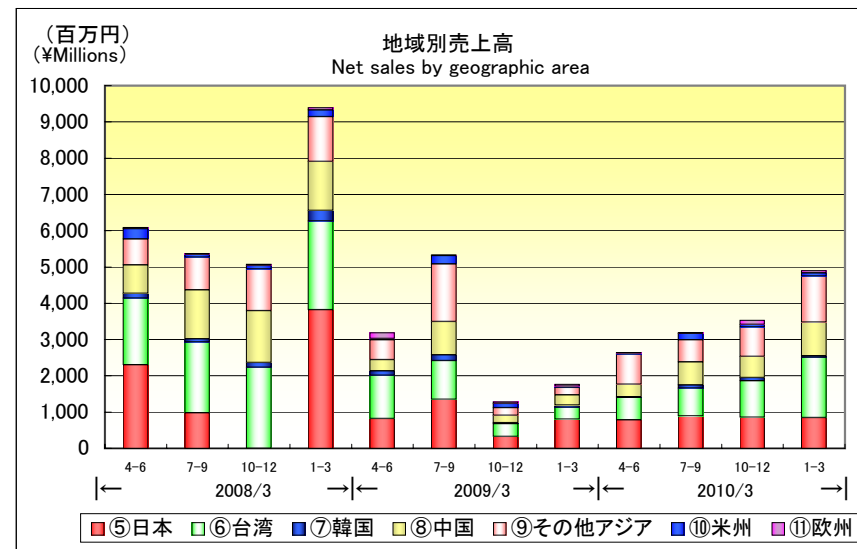
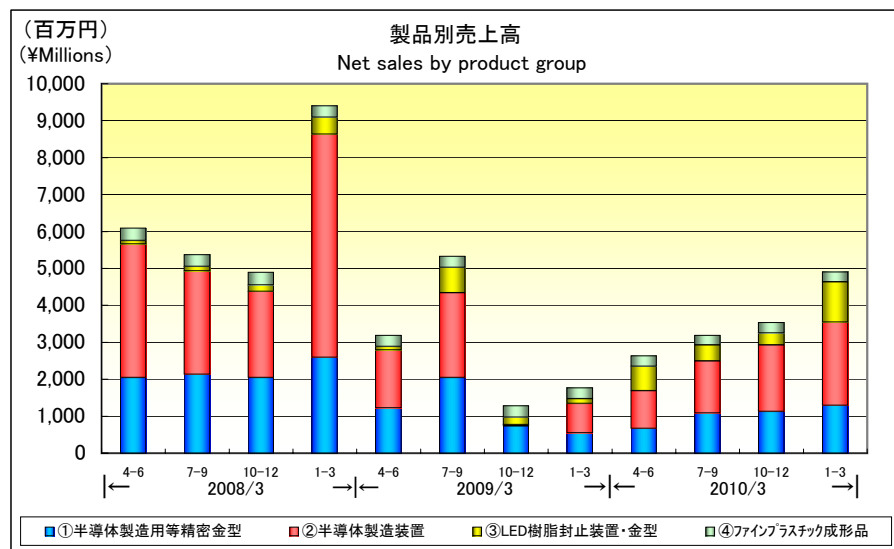


決算期		2007/3	2008/3	2009/3	2010/3
経営成績・財政状態 Operating results and financial conditions					
売上高	①Net sales	25,159	25,753	11,577	14,274
営業利益	Operating income	1,224	2,381	-3,337	-338
経常利益	Ordinary income	1,289	2,125	-3,677	-345
当期純利益	Net income	1,038	2,118	-4,163	-330
総資産	Total assets	34,925	34,360	27,949	26,738
純資産	Net assets	14,941	16,394	11,089	11,091
1株当たり指標 Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	41.59	84.70	-166.45	-13.19
諸指標 Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	7.4	13.5	-30.3	-3.0
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	3.6	6.1	-11.8	-1.3
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	4.9	9.2	-28.8	-2.4
自己資本比率	Equity ratio	42.8	47.7	39.7	41.5
増減率 Percent change					
決算期		2007/3	2008/3	2009/3	2010/3
売上高	Net sales	28.1	2.4	-55.8	23.3
営業利益	Operating income	-	94.5	-	-
経常利益	Ordinary income	-	64.8	-	-
当期純利益	Net income	-	104.0	-	-

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期	
2009/9	5,831
	-867
	-1,037
	-979
	25,122
	10,200
	-39.15
	-9.5
	-4.1
	-14.9
	40.6
決算期	
2009/9	71.5
	-
	-
	-

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



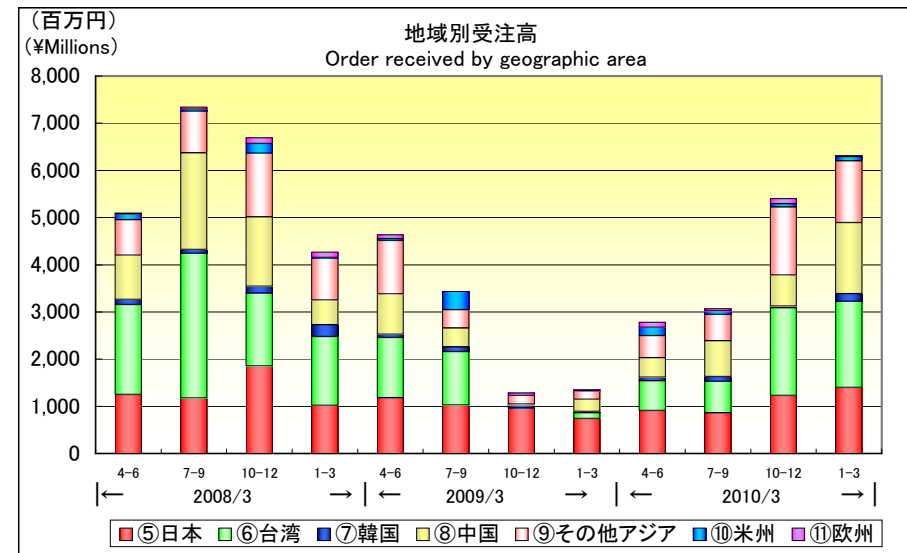
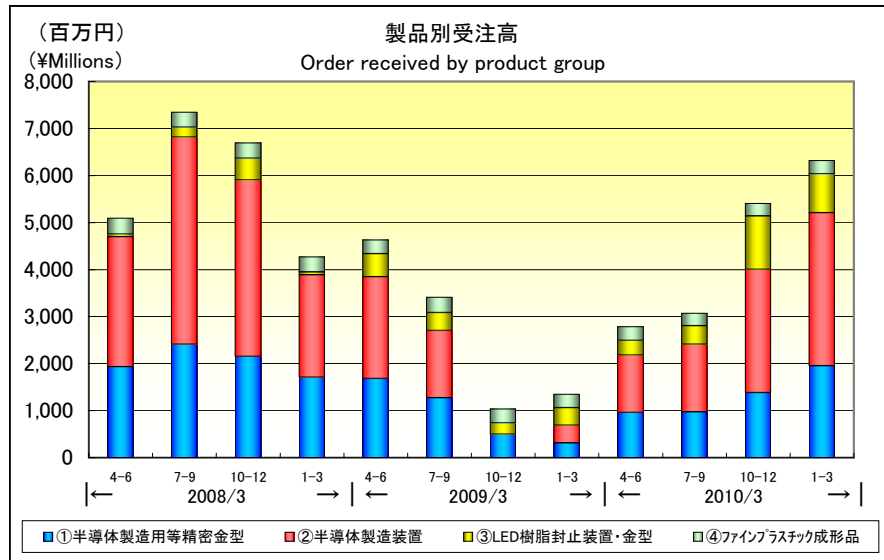
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2008/3					2009/3					2010/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	2,045	2,134	2,049	2,587	8,815	1,218	2,046	739	547	4,552	665	1,086	1,127	1,287	4,167
半導体製造装置 ②Semiconductor manufacturing equipment	3,615	2,794	2,323	6,045	14,778	1,575	2,299	29	796	4,700	1,021	1,407	1,801	2,253	6,484
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	93	122	176	454	846	95	681	202	128	1,107	659	435	325	1,100	2,520
ファインプラスチック成形品 ④Engineering plastic molded products	336	319	345	312	1,313	302	307	310	295	1,217	293	261	283	263	1,102
月平均	2,030	1,789	1,631	3,132	2,146	1,064	1,778	428	589	965	880	1,063	1,179	1,635	1,190

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2008/3					2009/3					2010/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274
日本 ⑤Japan	2,300	983	-186	3,826	6,924	820	1,347	329	805	3,302	782	892	856	847	3,379
アジア太平洋 Asia pacific	3,477	4,283	4,941	5,318	18,020	2,177	3,740	794	876	7,587	1,811	2,100	2,492	3,900	10,305
(内 台湾) ⑥Taiwan	1,841	1,944	2,237	2,443	8,465	1,195	1,067	355	325	2,943	618	763	1,002	1,660	4,044
(内 韓国) ⑦Korea	131	89	130	287	639	118	166	18	58	362	22	92	92	45	253
(内 中国) ⑧China	781	1,350	1,425	1,351	4,908	309	919	209	287	1,726	341	635	585	926	2,490
(内 その他アジア) ⑨Other asia	722	899	1,148	1,235	4,006	553	1,587	210	204	2,555	829	608	811	1,267	3,516
米州 ⑩America	284	83	97	188	654	31	226	115	36	409	29	182	74	95	382
欧州 ⑪Europe	28	19	41	65	154	163	21	44	49	277	17	14	113	62	207

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



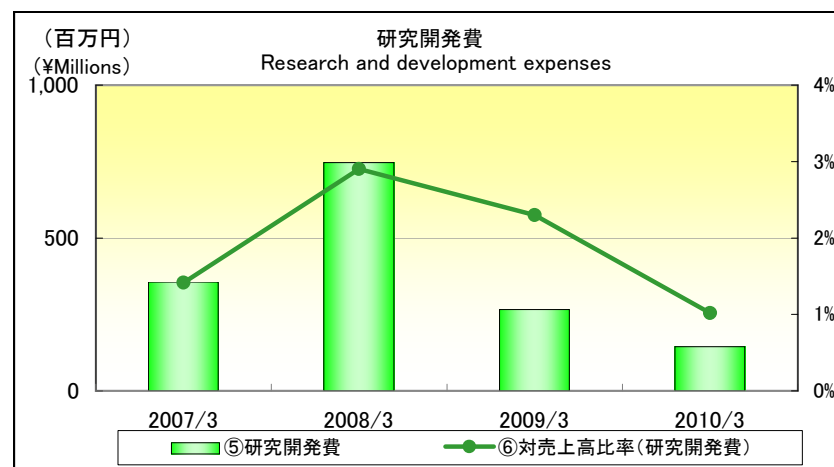
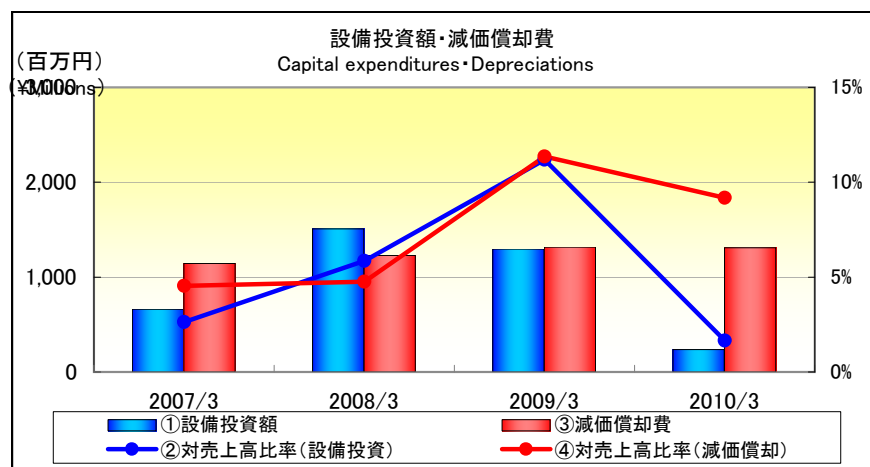
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2008/3					2009/3					2010/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,937	2,411	2,149	1,708	8,207	1,679	1,275	498	314	3,767	961	976	1,383	1,951	5,273
半導体製造装置 ②Semiconductor manufacturing equipment	2,760	4,404	3,753	2,178	13,096	2,166	1,431	-82	376	3,892	1,217	1,433	2,618	3,255	8,524
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	57	210	466	62	797	492	376	234	372	1,477	311	395	1,138	827	2,673
ファインプラスチック成形品 ④Engineering plastic molded products	342	318	328	318	1,308	296	326	301	288	1,212	295	264	267	282	1,110
月平均	1,699	2,448	2,232	1,422	1,951	1,545	1,137	317	450	863	929	1,023	1,802	2,105	1,465

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2008/3					2009/3					2010/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581
日本 ⑤Japan	1,249	1,176	1,854	1,015	5,295	1,178	1,024	966	742	3,911	910	863	1,229	1,400	4,404
アジア太平洋 Asia pacific	3,706	6,078	4,515	3,125	17,425	3,339	2,026	-47	578	5,897	1,590	2,083	3,995	4,801	12,471
(内 台湾) ⑥Taiwan	1,909	3,063	1,548	1,459	7,981	1,277	1,135	-307	118	2,223	627	667	1,858	1,823	4,976
(内 韓国) ⑦Korea	108	81	143	253	586	70	100	61	32	266	75	97	31	160	364
(内 中国) ⑧China	935	2,054	1,471	525	4,986	854	404	18	254	1,531	415	764	663	1,507	3,351
(内 その他アジア) ⑨Other asia	753	878	1,351	887	3,871	1,136	386	180	172	1,875	471	554	1,442	1,310	3,778
米州 ⑩America	113	41	202	17	375	39	386	-22	7	410	175	74	73	93	417
欧州 ⑪Europe	28	50	124	110	313	78	-27	55	23	130	109	48	108	20	287

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結) (Consolidated)		2007/3	2008/3	2009/3	2010/3
決算期					
キャッシュフロー	Cash flows				
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	1,894	2,587	606	2,494
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	252	-1,083	-1,490	-290
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-2,203	-1,947	1,972	-2,733
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at	3,542	3,351	4,399	3,836
設備投資額	①Capital expenditures	663	1,508	1,296	236
対売上比率	②Ratio of sales	2.64	5.86	11.19	1.65
減価償却費	③Depreciations	1,144	1,227	1,315	1,309
対売上比率	④Ratio of sales	4.55	4.76	11.36	9.17
研究開発費	⑤Research and development expenses	356	747	266	145
対売上比率	⑥Ratio of sales	1.42	2.90	2.30	1.02

(単位: 百万円/¥Millions)

2009/9
738
-318
-1,709
3,071
150
2.57
639
10.96
70
1.20